



☆【大阪】新規低伝送損失基板材料の要素技術開発及び新商品開発【PID 電子材料事業部】

パナソニックインダストリー株式会社での募集です。電子デバイス研究開発のご経験...

## Job Information

### Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

### Hiring Company

パナソニックインダストリー株式会社

### Job ID

1483675

### Industry

Electronics, Semiconductor

### Job Type

Permanent Full-time

### Location

Osaka Prefecture

### Salary

5 million yen ~ 8.5 million yen

### Work Hours

08:30 ~ 17:00

### Holidays

【有給休暇】有給休暇は入社時から付与されます 年次有給休暇（年間25日付与、初年度のみ入社月に応じ付与。2021年度平均取得日...

### Refreshed

June 21st, 2024 13:38

## General Requirements

### Career Level

Mid Career

### Minimum English Level

Daily Conversation

### Minimum Japanese Level

Native

### Minimum Education Level

Bachelor's Degree

### Visa Status

Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2162375】

### ●担当業務と役割

当事業部が保有しているコア技術は、熱硬化性樹脂の材料設計技術です。

近年、5G/6Gと信号の高速化がますます進展しており、それに適用するため熱硬化性低損失基板の市場が拡大しています。

将来、この事業領域をさらに拡大するためには、樹脂に加えて、無機充填剤/基材/金属箔等の幅広い知識、経験を持った技術者を必要としています。

未来の配線板に適応される新しい材料の開発に加えて、顧客と一緒に新しい市場を切り開いて頂きたいと考えています。

- 具体的な仕事内容
  - ・新規絶縁材料の要素技術開発、商品開発、プロセス技術開発、評価技術開発
  - ・海外を含む顧客対応、顧客ニーズ調査、技術マーケティング活動
- この仕事を通じて得られること
  - ・材料で社会基盤を支えている達成感を得ることができます。材料（商品）の性能向上により、高速通信・省エネルギー・省電力に貢献する機器の実現に貢献 等
  - ・世界のリーディングカンパニーとの信頼関係、人脈構築
- 職場の雰囲気
  - ・リーダークラスには比較的若い世代が多く、中途入社者も数人います。年齢や役職に関係なくフラットに議論・相談を行っている組織です。
  - ・新しいことに挑戦できる、活気のある職場です。実際に自分たちの手足を動かして、スピード感を持って業務にあたっています。
  - ・出張やテレワーク等、個人の裁量に任せられています。
- キャリアパス
  - ・初期配属の部署の仕事にとどまらず、様々な職務を経験することも可能です。
  - ・例えば、初期配属は要素技術開発ですが、商品開発や製造技術を経験することが可能です。米国にも拠点を構えていますので、駐在する可能性もございます。

---

## Required Skills

[経験] ・硬化性樹脂を用いた材料開発および材料設計の経験 [知識] ・化学反応等に関する有機化学の知識 ・一般化学（有機、無機）に関する知識 ・一般化学分析に関する知識 ・低誘電材料に関する知識 [スキル] ・絶縁材料の設計スキル ・材料の配合、混練スキル ・材料の物性評価スキル ・顧客対応スキル

---

## Company Description

電気部品・電子部品・制御機器・電子材料等の開発・製造・販売